

上海收购库存电子IC，现金买卖，欢迎来购

产品名称	上海收购库存电子IC，现金买卖，欢迎来购
公司名称	深圳市邵昕电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邵昕电子科技 价格:请电话联系报价或加QQ 回收范围:回收各种电子元器件
公司地址	深圳市福田区华强北街道佳和华盛大厦
联系电话	0135-30101390 13530101390

产品详情

深圳邵昕电子回收公司 求购工厂库存电子二三极管 现金回收工厂库存呆滞电子料
求购工厂处理积压电子库存元件 收购 OEM厂电子库存滞料 收集工厂库存电子料，出价合理
邵昕电子回收公司 回收电子元件:ic、二三极管、电容、电阻、电感、电位器、连接器、晶振、滤波器、
变压器、功率模块。

集成电路芯片封装概述编辑 播报

封装概念:

狭义:利用膜技术及微细加工技术，将芯片及其他要素在框架或基板上布置、粘贴固定及连接，引出接线端子并通过可塑性绝缘介质灌封固定，构成整体立体结构的工艺。

广义:将封装体与基板连接固定，装配成完整的系统或电子设备，并确保整个系统综合性能的工程。

芯片封装实现的功能：

1、传递功能；2、传递电路信号；3、提供散热途径；4、结构保护与支持。

封装工程的技术层次：

封装工程始于集成电路芯片制成之后，包括集成电路芯片的粘贴固定、互连、封装、密封保护、与电路板的连接、系统组合，直到*终产品完成之前的所有过程。

**层次:又称为芯片层次的封装，是指把集成电路芯片与封装基板或引脚架之间的粘贴固定、电路连线与封装保护的工艺，使之成为易于取放输送，并可与下一层次组装进行连接的模块(组件)元件。

第二层次:将数个第一层次完成的封装与其他电子元器件组成--个电路卡的工艺。第三层次:将数个第二层次完成的封装组装的电路卡组合成在一个主电路板上使之成为一个部件或子系统的工艺。

第四层次:将数个子系统组装成为一个完整电子产品的工艺过程。

在芯片上的集成电路元器件间的连线工艺也称为零级层次的封装，因此封装工程也可以用五个层次区分。

封装的分类:

- 1、按封装集成电路芯片的数目:单芯片封装(scP)和多芯片封装(MCP)；
- 2、按密封材料区分:高分子材料(塑料)和陶瓷；
- 3、按器件与电路板互连方式:引脚插入型(PTH)和表面贴装型(SMT)4、按引脚分布形态:单边引脚、双边引脚、四边引脚和底部引脚；

SMT器件有L型、J型、I型的金属引脚。

SIP :单列式封装 SQP:小型化封装 MCP:金属罐式封装 DIP:双列式封装 CSP:芯片尺寸封装QFP:
四边扁平封装 PGA:点阵式封装 BGA:球栅阵列式封装LCCC: 无引线陶瓷芯片载体